

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	5
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요 .....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	12
□ 재무제표의 승인 .....	12
□ 정관의 변경 .....	23
□ 이사의 선임 .....	26
□ 이사의 보수한도 승인 .....	30
□ 감사의 보수한도 승인 .....	31
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	32
가. 제출 개요 .....	32
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	32
※ 참고사항 .....	33

# 주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사  
대 표 이 사 : 이수훈, 김태수  
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)  
(전 화) 052)283-9000  
(홈페이지) <https://www.dshm.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김태수  
(전 화) 052)283-9000

# 주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)  
[덕산하이메탈(주) 본사 1층 대회의실]

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표  
승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 후보 전병선 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 후보 김 별 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

### 4. 경영참고사항 등의 비치

「상법」 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

### 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

## 7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

### 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

### 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

- 2026년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

## 8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 임감증명서), 대리인의 신분증

(※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2026년 03월 12일  
덕산하이메탈 주식회사  
대표이사 이 수 훈, 김 태 수 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	
				차명철 (출석률 : 100%)	박홍주 (출석률 : 100%)
				찬반여부	
25-01	2025.01.12	1. 장학재단 기부 결의의 건	가결	찬성	찬성
25-02	2025.02.10	1. 브랜드 사용계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		2. 경영관리 용역계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성
		3. 정보시스템 통합서비스 지원계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
25-03	2025.02.27	1. 제26기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
25-04	2025.03.05	1. 제26기(2024년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	찬성	찬성
25-05	2025.03.07	1. 산업은행 운전자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성
25-06	2025.03.21	1. 덕산넵코스 제13기 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건			
		1-1. 제13기(2024년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
		1-2. 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성
		1-3. 이사 선임의 건			
		1-3-가. 사내이사 후보자 손석보	가결	찬성	찬성
		1-3-나. 사외이사 후보자 김주재	가결	찬성	찬성
		1-4. 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성
		1-5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
		1-6. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
		2. 시리우스홀딩스 제2기 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건			
		2-1. 제2기(2024년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
		2-2. 이사보수액 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
		2-3. 감사보수액 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
		3. 덕산네오룩스 제11기 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건			
		3-1. 제11기(2024년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
		3-2. 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성
		3-3. 이사 선임원건			
		3-3-가. 사내이사 후보자 이범성	가결	찬성	찬성
		3-3-나. 기타비상무이사 후보자 강세원	가결	찬성	찬성
		3-4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
3-5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성		
25-07	2025.03.28	1. 임원 보수 약정 승인의 건 (주1)	가결	찬성	찬성
		2. 임원 보수 약정 추인의 건	가결	찬성	찬성
		3. 이사회 의장 선출의 건	가결	찬성	찬성
25-8	2025.04.21	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성
25-9	2025.04.25	1. 시리우스홀딩스(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성
		2. 덕산에테르시티(주) 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성
		3. 국민은행 운전자금 대출의 건	가결	찬성	찬성
25-10	2025.07.25	1. 국민은행 운전자금 대출의 건	가결	찬성	찬성

25-11	2025.08.27	1. 투자기업 풋옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성
		2. 내부회계관리규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성
		3. 임대차 계약 갱신 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성
25-12	2025.09.16	1. 우리은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성
25-13	2025.09.30	1. 임원배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성
25-14	2025.11.03	1. 자회사 "넵코어스 주식회사"의 한국거래소 코스닥 상장예비심사 신청 결정 동의의 건	가결	찬성	찬성
		2. 자회사 "넵코어스 주식회사" 지분전량 의무보유 확약 결정의 건	가결	찬성	찬성
		3. 기업은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성
		4. 수출입은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성
25-15	2025.11.28	1. 임대차 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

※ 박흥주 사외이사는 2025.12.12 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	10,000	47	23	-

※ 상기 주총승인금액은 제26기 정기주주총회에서 승인된 제27기(2025년) 이사보수한도 총액기준입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위 중에 있습니다.

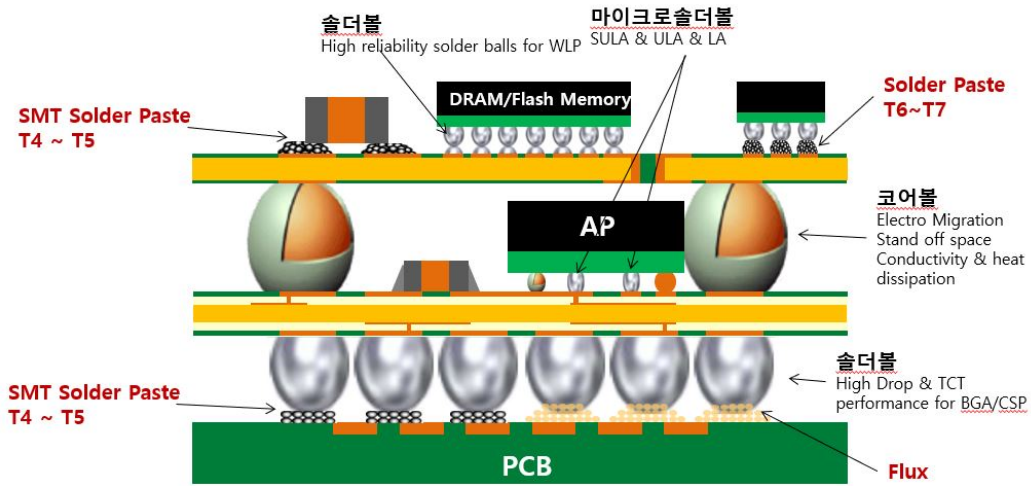
2019년 6월, 100% 지분투자방식으로 미얀마 현지법인(DS Myanmar)을 설립하였습니다. 미얀마 현지법인은 미얀마의 풍부한 광물자원을 활용하여 주석을 제련 및 판매하여 소재산업 경쟁력을 강화하고 솔더소재 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 설립되었습니다. 2021년 3월, 사업 다각화 목적으로 방위·우주항공사업 전문 기업인 덕산넵코어스의지분 63.24%를 취득 완료하였습니다. 덕산넵코어스는 항법기술을 보유하고 있으며, 이는 방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심기술로 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 2023년 11월 8일에 경영 자문 및 컨설팅업인 시리우스홀딩스를 지분출자, 설립하였습니다. 이어 2023년 12월 11일에는 시리우스홀딩스(주)가 고압가스용기 제조 및 판매업체인 덕산에테르씨티(주)의 지분을 91.88% 인수하며, 고압가스 및 수소용기 시장으로 진출하였습니다.

#### 가. 업계의 현황

반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜) 하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세가 이어지면서 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 당사는 130마이크론 미만의 초정밀솔더볼인 Micro Solder Ball을 독점적 지위를 통해 시장에 공급하고 있으며, 반도체가 고집적화 미세화로 발전함에 따라 마이크로 솔더볼의 수요도 지속 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

솔더볼 외 신규 아이템으로 Solder Paste가 있습니다. 솔더볼의 Powder 형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합과 접촉면의 산화 방지 및 Solder Ball 대체용으로서의 Bump 형성과 Pre-solder 역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더의 한 종류이므로 솔더볼과 유사한 시장 환경에서 사업을 영위하고 있습니다.

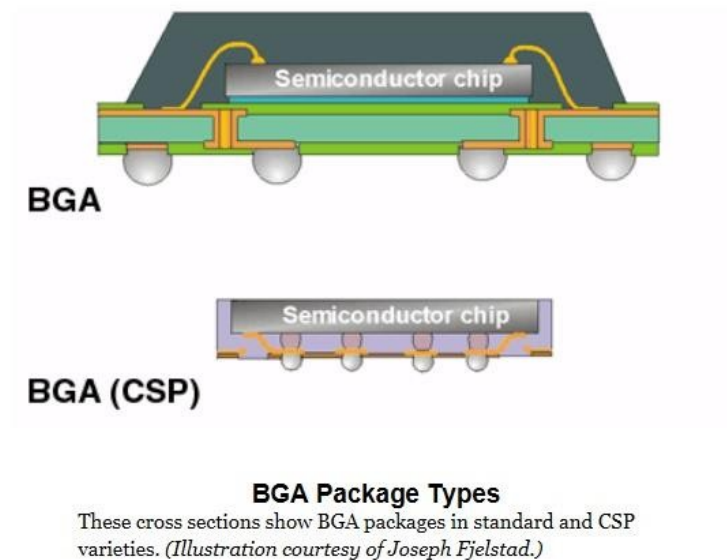


## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다.



솔더볼은 이러한 반도체의 첨단 패키지 기술인 BGA, CSP용 부품으로 칩과 기판을 연결하여

전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키징용 부품 소재입니다. 현재 BGA는 PC, 노트북의 안정적인 성장과 스마트폰과 소형 디지털 기기들의 성장으로 기인하고 있으며, 각종 디바이스의 경박단소화 및 고기능화(핀 수의 증가, 입출력 효율 증대 등)로 Lead Frame Type이 한계를 드러내 Substrate와 PCB의 결합방식은 주로 BGA(Ball Grid Array), PGA(Pin Grid Array), LGA(Land Grid Array)방식으로 전환되었으며, 패키징 방식 또한 CSP(Chip Scale Package) 등으로 전환되어 향후 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장될 것으로 기대하고 있습니다.

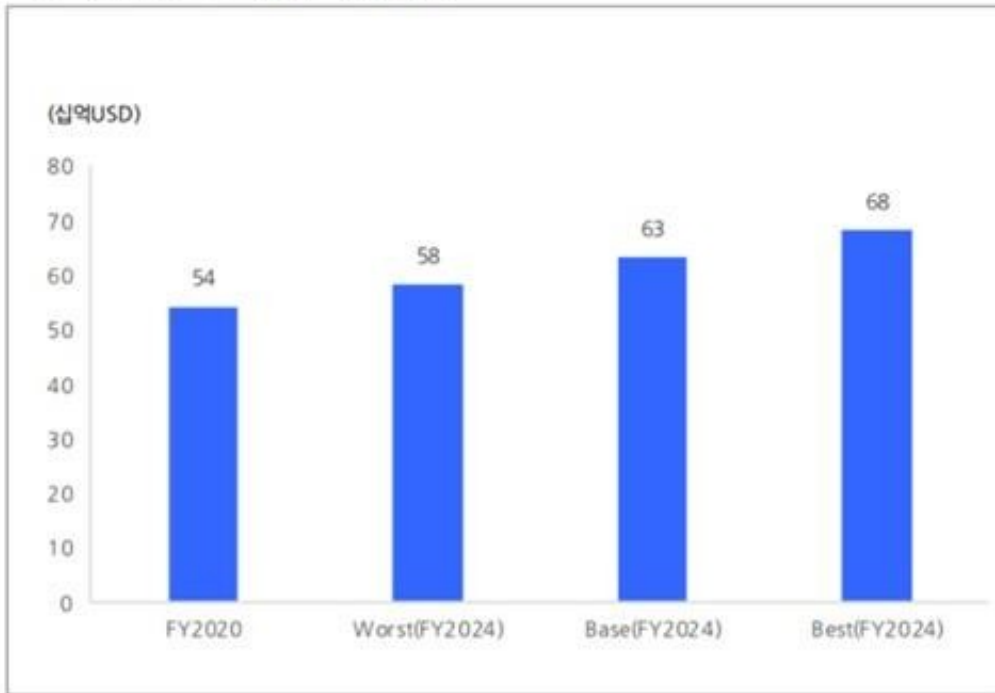
반도체 소재는 장비 대비 원가 비중이 낮은 반면 공정 수율 및 생산 현장에서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존 재료의 변경을 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 소재를 변경하기 위한 Qualification 과정에 수반되는 시간과 비용을 감수하면서까지 양산 중인 라인을 품질 검증을 위해 변경하여 사용하는 것은 매우 어려운 일입니다. 이러한 반도체 업체의 재료업체 변경에 대한 보수적인 경향 등으로 신규업체의 진입이 거의 불가능하게 되었습니다. 또한 고객사와의 문제 해결 과정에서 이루어지는 기술개발과 상호 보안상 이유 및 전 세계 BGA 시장의 30~40% 가량을 차지하는 한국 시장에서 Local Vendor라는 당사의 장점 등의 Synergy 효과로 인하여 업계에서 시장지배적 지위를 확보하고 있습니다.

솔더볼 외 신규 아이টে็ม으로 Solder Paste가 있습니다. 솔더볼의 Powder 형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합과 접촉면의 산화 방지 및 Solder Ball 대체용으로서의 Bump 형성과 Pre-solder 역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더의 한 종류이므로 솔더볼과 비슷한 시장 환경을 가지고 있습니다.

솔더볼 시장은 PC 시장과 스마트폰의 폭발적 성장과 더불어 동반 성장하였으며, 최근 4차 산업혁명에 따른 구글, 아마존 등 글로벌 IT 산업의 성장에 힘입어 다양한 분야로 분산, 확대되며 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징 산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 최근 전반적인 반도체 시장 성장과 2020년 이후 5G 적용 등으로 인한 솔더볼 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 그리고 최근 고성능반도체 칩 수요가과파른 증가 추세로 솔더볼의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

언택트(Untact) 시대가 서버, 개인용 의료기기 무인 배달 기기, 로봇 등 수요를 자극하면서 CPU, GPU, Sensor, DRAM 수요를 자극하고 있으며, 자율주행 자동차 기술 발전으로 도입 시기를 앞당길 전망이 예상됨에 따라 자율주행차에 탑재될 DRAM 수요는 현재보다 증가할 전망입니다. 이러한 반도체 분야의 수요 증가로 인하여 파운드리(Foundry), 메모리 투자가 증가될 것으로 예상되며 이에 따른 반도체 분야의 수요도 증가될 것으로 전망됩니다.

## 전세계 반도체 장비 시장 전망

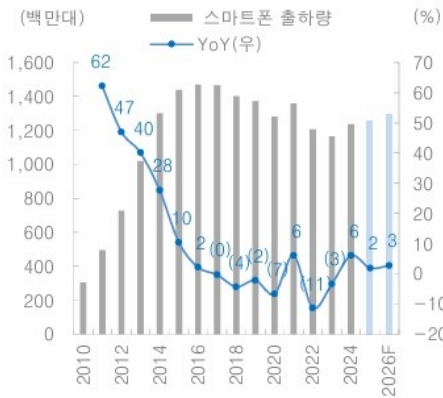


자료: TEL, 현대차증권

최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC 내 SSD 탑재 비중이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 스마트폰 시장이 급성장 및 대중화되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor) 칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

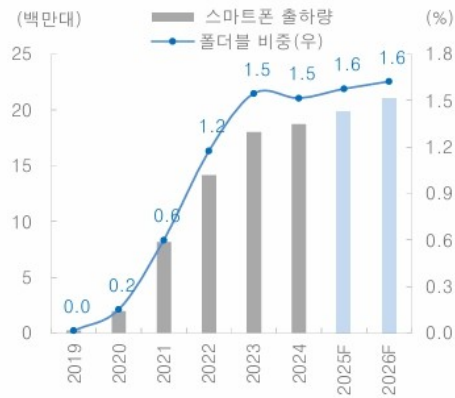
당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장 하였습니다. 5G 도입에 따른 스마트폰의 교체 주기의 단축화와 5G의 본격적인 상용화에 힘입어 5G 스마트폰의 출하량은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 폴더블 스마트폰의 등장으로 하이엔드 스마트폰 시장 성장을 이끌 것으로 기대되며 이 또한 전반적인 스마트폰출하량 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

글로벌 스마트폰 시장 전망



주: 25F, 26F- 당사 추정치 적용  
자료: IDC, 대신증권 Research Center

폴더블폰 성장 전망 및 비중 추이(2020~)



자료: IDC, 대신증권 Research Center

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	회사명	주요사업	당사 지분율	비고
비상장	덕산에스지(주)	전자기기용 비산방지데코필름, 전자필름 제조업	70.8%	종속기업
비상장	DS MYANMAR CO.,LTD.	비철금속 제조 및 판매 Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석괴 제조 및 판매	100.0%	종속기업
비상장	덕산넵코어스(주)	GPS기술을 원천으로 한 Location & Timing 관련 제품 제조업	61.1%	종속기업
비상장	시리우스홀딩스(주)	경영자문 및 경영컨설팅업 (덕산에테르씨티(주) 지분 92% 보유)	93.4%	종속기업
비상장	덕산에테르씨티(주)	반도체 디스플레이용 초대형 용기 및 수소용기 제조업	-	종속기업

(\*) 덕산에테르씨티(주)는 2023년 12월 11일 덕산하이메탈(주)의 자회사인 시리우스홀딩스(주)가 지분 91.88%를 인수함에 따라, 덕산하이메탈(주)가 실질적으로 경영을 지배하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 경쟁사로는 일본의 센쥬메탈 및 국내 업체 MKE, 독일의 Heraeus 등이 있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력을 기울이고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정받아 대량 납품 중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발맞추어 극미세 솔더볼 등의 개발을 완료, 기술 경쟁력에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다.

세계 솔더볼 시장점유율은 일본 약 30~35% / 한국 약 25~30% / 대만 약 15~20% / 기타(미국, 중국, 유럽 등) 약 15~20% 수준으로 추정됩니다. 이는 아시아-태평양 국가들이 솔더볼 및 반도체 패키징 생산의 핵심 허브를 형성하고 있기 때문입니다. 또한 세계 시장에서 당사는 2위 업체로서의 위치를 차지하고 있습니다. 세계 패키징(테스트 포함) 업체는 한국(35%), 대만(35%), 나머지 일본, 중국, 말레이시아 등을 포함한 아시아/태평양 지역의 업체

들이 주도하고 있습니다. 세계 패키징 시장은 시스템 반도체의 발전과 연동되어 성장하며, 고부가가치 제품(시스템반도체) 위주로 기술과 시장이 변화되고 있습니다.

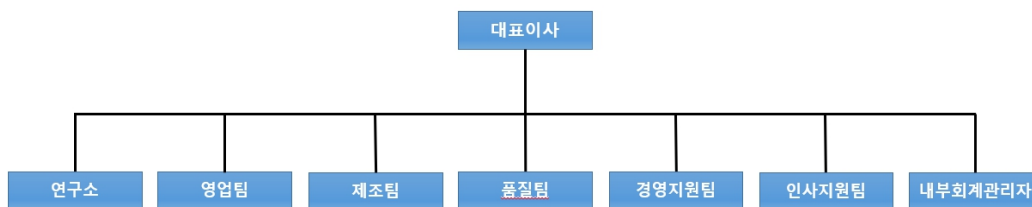
### (3) 시장의 특성

현재 솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 당사는 세계 솔더볼 시장에서 매출액 2위의 점유율을 유지 중이며 대부분의 고객사는 반도체 산업의 메이저 업체로 구성되어 있습니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자 부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT 산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다. 반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 현재는 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체 경기와 맥락을 같이 할 것으로 예상됩니다. 특히 코로나19 팬데믹을 계기로 비대면 환경에 대한 수요가 급증하며 스마트폰, 웨어러블 기기, IoT 디바이스 등에서 반도체 수요가 대폭 확대되었습니다. 이러한 변화는 일시적 현상에 그치지 않고, 디지털 전환 가속화와 함께 구조적인 수요 증가로 이어졌으며, 지금도 그 흐름은 지속되고 있습니다. 향후에는 AI, 자율주행, 5G/6G 통신, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 신기술의 확산에 따라 솔더볼 수요 역시 계속 증가할 것으로 전망됩니다.

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발 및 제조 회사로서 Solder Joint 부문의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율 향상 및 리드타임 단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저융점)개발 능력과 고강도 볼, 저융점 L-Free alloy, 무변색 볼 제조, 마이크로 솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자(주), 앰코 테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(앰코 중국), ATP(앰코필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 절대적 시장지배를 통하여 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D 투자를 통한 제품의 성능 개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint 관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징 시장에 중요 요소로 부각됨에 따라 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술 개발 및 신규 아이템 개발 등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

### (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

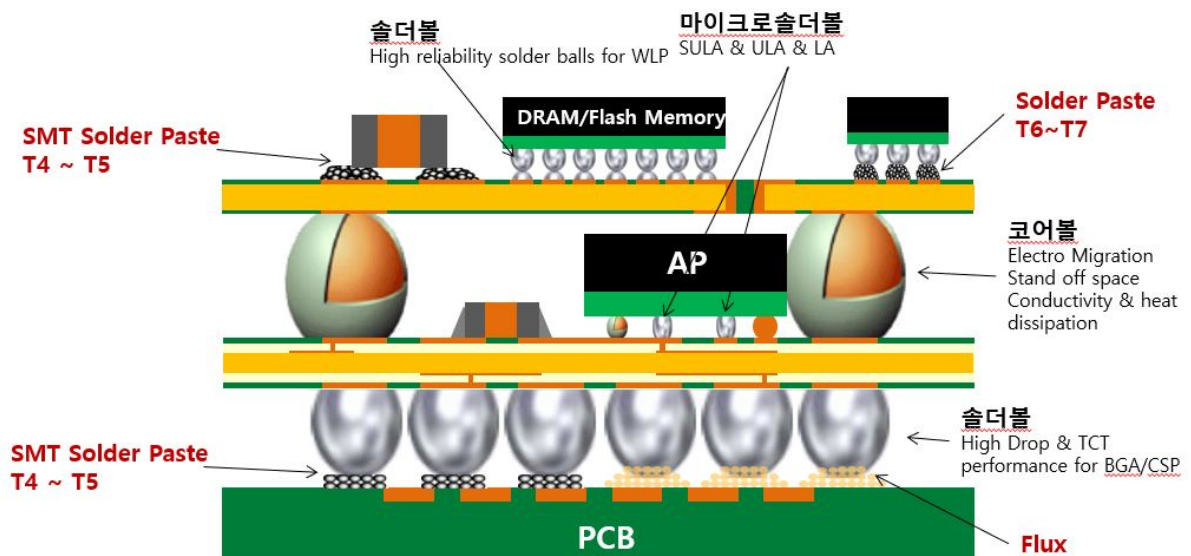
### □ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위 중에 있습니다. 반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땀) 하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세가 이어지면서 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 당사는 130마이크론 미만의 초정밀솔더볼인 Micro Solder Ball을 독점적 지위를 통해 시장에 공급하고 있으며, 반도체가 고집적화 미세화로 발전함에 따라 마이크로 솔더볼의 수요도 지속 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

솔더볼 외 신규 아이템으로 Solder Paste가 있습니다. 솔더볼의 Powder 형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합과 접촉면의 산화 방지 및 Solder Ball 대체용으로서의 Bump 형성과 Pre-solder 역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더의 한 종류이므로 솔더볼과 유사한 시장 환경에서 사업을 영위하고 있습니다.



#### 덕산하이메탈 솔더제품 구성

사업 다각화 목적으로 방위·우주항공산업 전문 기업인 덕산넵코어스 주식회사의 지분 63.24%를 취득 완료하였습니다. 덕산넵코어스 주식회사는 항법기술을 보유하고 있으며 이는 방위 산업 뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 2023년 11월 8일에 경영 자문 및 컨설팅업인 시리우스홀딩스를 지분출자, 설립하였습니다. 이어, 2023년 12월 11일에는 시리우스홀딩스(주)가 고압가스용기 제조 및 판매업체인 덕산에테르씨티(주)의 지분을 91.88% 인수하였습니다.

덕산에테르씨티(주)는 국내 유일의 반도체/디스플레이용 초대형 용기 및 수소용기 제조 업체입니다. 주요 제품으로는 반도체 및 디스플레이용의 특수가스용 용기와 항공/우주 및 기초과학, 방위산업, 드릴쉽용 저장용기 등의 산업가스 및 특수 목적 용기를 생산하고 있습니다. 특히, 수소 운반 및 수소 저장 목적인 튜브트레이러와 고정식 저장용기에 쓰이는 Type1 수소용 용기를 독점적으로 생산 및 공급하고 있으며 차량 수소연료 탱크 목적 등으로 쓰이는 Type4의 용기 등의 제품군으로 사업의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.  
 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시 변경될 수 있습니다.

**[연결기준]**

연 결 재 무 상 태 표  
 제 27 기말 2025년 12월 31일 현재  
 제 26 기말 2024년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		178,554,026,317		214,254,425,024
1. 현금및현금성자산	66,554,904,400		69,391,883,139	
2. 매출채권	45,436,205,837		49,290,968,829	
3. 계약자산	1,948,046,031		1,584,204,478	
4. 기타유동수취채권	2,956,395,381		4,836,397,963	
5. 기타유동자산	6,270,265,091		6,009,604,046	
6. 당기손익-공정가치측정금융자산	-		203,285,240	
7. 기타유동금융자산	4,000,000,000		34,000,000,000	
8. 재고자산	51,283,540,937		48,938,081,329	
9. 당기법인세자산	104,668,640		-	
Ⅱ. 비유동자산		480,410,241,446		604,233,005,021
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,511,167,189		22,664,602,920	
2. 기타비유동수취채권	10,760,792,126		11,437,083,562	
3. 순확정급여자산	936,524,117		-	
4. 관계기업투자주식	211,436,887,077		191,728,445,808	
5. 유형자산	110,278,799,686		111,687,775,925	
6. 사용권자산	3,047,092,558		4,833,273,284	
7. 무형자산	129,316,838,359		253,459,291,486	
8. 이연법인세자산	3,349,646,347		2,440,343,392	
9. 기타비유동자산	4,772,493,987		5,982,188,644	
자 산 총 계		658,964,267,763		818,487,430,045
부 채				
Ⅰ. 유동부채		193,777,907,902		108,378,076,882
1. 매입채무	8,857,017,440		8,403,209,437	
2. 단기차입금	153,301,073,732		63,811,885,340	
3. 기타유동금융부채	15,116,376,585		12,777,840,177	
4. 기타유동부채	12,059,614,963		16,461,159,034	
5. 당기법인세부채	1,161,654,931		3,541,755,682	

6. 계약부채	2,345,660,048		2,440,691,735	
7. 총당부채	936,510,203		933,442,906	
8. 당기손익-공정가치측정금융부채	-		8,092,571	
II. 비유동부채		126,422,122,468		255,257,663,455
1. 장기차입금	102,756,326,508		219,667,013,079	
2. 기타비유동금융부채	3,392,115,916		5,221,208,857	
3. 기타비유동부채	2,263,607,390		6,452,618,955	
4. 이연법인세부채	16,887,619,350		22,816,648,780	
5. 순확정급여부채	1,122,453,304		1,100,173,784	
부 채 총 계		320,200,030,370		363,635,740,337
자 본				
I. 지배기업의 소유지분		206,474,694,125		313,377,936,666
1. 자본금	9,087,400,400		9,087,400,400	
2. 주식발행초과금	90,201,314,524		90,201,314,524	
3. 기타포괄손익누계액	3,272,951,601		4,889,460,894	
4. 기타자본구성요소	(64,914,523,590)		(65,357,478,562)	
5. 이익잉여금	168,827,551,190		274,557,239,410	
II. 비지배지분		132,289,543,268		141,473,753,042
1. 비지배지분	132,289,543,268		141,473,753,042	
자 본 총 계		338,764,237,393		454,851,689,708
부 채 와 자 본 총 계		658,964,267,763		818,487,430,045

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 매출액	236,404,536,110	235,891,931,037
II. 매출원가	192,335,088,572	179,896,193,196
III. 매출총이익	44,069,447,538	55,995,737,841
IV. 판매비와관리비	41,256,424,497	37,357,066,511
V. 영업이익(손실)	2,813,023,041	18,638,671,330
VI. 기타수익	2,339,803,396	4,702,174,363
VII. 기타비용	118,549,385,775	1,302,930,505
VIII. 금융수익	3,008,187,240	21,176,667,149
IX. 금융비용	30,282,095,731	17,883,501,146
X. 관계기업투자이익	20,539,408,264	17,367,285,695
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(120,131,059,565)	42,698,366,886
X II. 법인세수익(비용)	(4,426,465,390)	11,403,062,682
X III. 당기순이익(손실)	(115,704,594,175)	31,295,304,204
X IV. 기타포괄이익(손실)	(1,963,165,265)	4,104,991,491
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	369,392,532	(1,206,666,239)
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	449,103,637	(968,236,133)
(2) 관계기업 재측정 요소	(79,711,105)	(238,430,106)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,332,557,797)	5,311,657,730
(1) 해외사업환산손익	(1,543,272,827)	5,054,296,215
(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(789,284,970)	257,361,515
X V. 당기총포괄이익	(117,667,759,440)	35,400,295,695
X VI. 당기순이익(손실)의 귀속	(115,704,594,175)	31,295,304,204
1. 지배지분순이익(손실)	(106,024,997,636)	20,385,571,517
2. 비지배지분순이익	(9,679,596,539)	10,909,732,687
X VII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속	(117,667,759,440)	35,400,295,695
1. 지배지분포괄이익(손실)	(108,120,194,589)	23,985,777,282
2. 비지배지분포괄이익	(9,547,564,851)	11,414,518,413
X VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당손익	(2,333)	449
2. 희석주당손익	(2,333)	449

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계		
2024. 1. 1 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	96,181,710	(65,357,478,562)	255,364,741,312	289,392,159,384	132,197,075,187	421,589,234,571
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	20,385,571,517	20,385,571,517	10,909,732,687	31,295,304,204
해외사업환산손익	-	-	4,535,917,669	-	-	4,535,917,669	518,378,546	5,054,296,215
관계기업의 재측정요소	-	-	-	-	(238,430,106)	(238,430,106)	-	(238,430,106)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(954,643,313)	(954,643,313)	(13,592,820)	(968,236,133)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	257,361,515	-	-	257,361,515	-	257,361,515
총포괄손익 계	-	-	4,793,279,184	-	19,192,498,098	23,985,777,282	11,414,518,413	35,400,295,695
소유주와의 거래								
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	(600,997,283)	(600,997,283)
배당	-	-	-	-	-	-	(4,056,390)	(4,056,390)
신종자본증권의 배당	-	-	-	-	-	-	(1,532,786,885)	(1,532,786,885)
소유주와의 거래 계	-	-	-	-	-	-	(2,137,840,558)	(2,137,840,558)
2024.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	4,889,460,894	(65,357,478,562)	274,557,239,410	313,377,936,666	141,473,753,042	454,851,689,708
2025. 1. 1 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	4,889,460,894	(65,357,478,562)	274,557,239,410	313,377,936,666	141,473,753,042	454,851,689,708
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	(106,024,997,636)	(106,024,997,636)	(9,679,596,539)	(115,704,594,175)
해외사업환산손익	-	-	(1,601,221,399)	-	-	(1,601,221,399)	57,948,572	(1,543,272,827)
관계기업의 재측정요소	-	-	-	-	(79,711,105)	(79,711,105)	-	(79,711,105)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	375,020,521	375,020,521	74,083,116	449,103,637
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(15,287,894)	(773,997,076)	-	(789,284,970)	-	(789,284,970)
총포괄손익 계	-	-	(1,616,509,293)	(773,997,076)	(105,729,688,220)	(108,120,194,589)	(9,547,564,851)	(117,667,759,440)
소유주와의 거래								
종속기업의 유상증자 등	-	-	-	1,216,952,048	-	1,216,952,048	1,411,314,358	2,628,266,406
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	492,040,719	492,040,719
신종자본증권의 배당	-	-	-	-	-	-	(1,540,000,000)	(1,540,000,000)
소유주와의 거래 계	-	-	-	1,216,952,048	-	1,216,952,048	363,355,077	1,580,307,125

2025.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	3,272,951,601	(64,914,523,590)	168,827,551,190	206,474,694,125	132,289,543,268	338,764,237,393
-------------------	---------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,837,216,218		13,781,837,925
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	19,249,714,899		33,460,914,093	
2. 이자의 수취	2,781,329,027		3,227,615,072	
3. 이자의 지급	(12,280,539,451)		(14,833,191,828)	
4. 법인세 납부	(4,913,288,257)		(8,073,499,412)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		19,672,315,202		(31,988,938,846)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,295,310,821		61,612,843,650	
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	206,013,151		3,727,762,133	
(2) 정부보조금의 수령	1,512,954,542		5,539,361,480	
(3) 유형자산의 처분	4,053,973		290,546,871	
(4) 단기금융상품의 감소	34,000,000,000		51,408,106,475	
(5) 임차보증금의 감소	1,204,698,279		482,066,691	
(6) 파생상품금융자산의 감소	151,590,876		-	
(7) 장기대여금의 감소	-		165,000,000	
(8) 단기대여금의 감소	3,216,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(20,622,995,619)		(93,601,782,496)	
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 증가	(3,346,073)		(181,138,108)	
(2) 장기대여금의 증가	(10,000,000)		(40,000,000)	
(3) 유형자산의 취득	(14,625,665,911)		(20,919,335,060)	
(4) 무형자산의 취득	(333,437,470)		(453,966,384)	
(5) 단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)		(71,000,000,000)	
(6) 임차보증금의 증가	(489,746,165)		(980,882,129)	
(7) 단기대여금의 증가	(1,158,800,000)		-	
(8) 파생상품금융자산의 취득	-		(26,460,815)	
(9) 장기금융상품의 증가	(2,000,000)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(27,312,843,454)		31,371,219,957
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	134,082,586,931		51,448,933,978	
(1) 단기차입금의 증가	37,291,242,744		33,252,890,429	
(2) 장기차입금의 증가	94,177,546,187		18,196,043,549	
(3) 유상증자	613,800,000		-	
(4) 전환상환우선주주의 발행	1,999,998,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(161,395,430,385)		(20,077,714,021)	
(1) 리스부채의 감소	(775,052,803)		(537,960,473)	
(2) 단기차입금의 감소	(50,968,204,824)		(16,777,740,273)	
(3) 장기차입금의 감소	(108,112,172,758)		(1,225,170,000)	
(4) 신종자본증권의 배당	(1,540,000,000)		(1,532,786,885)	
(5) 배당	-		(4,056,390)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		(2,803,312,034)		13,164,119,036

V.기초의 현금및현금성자산		69,391,883,139		55,012,691,766
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과		(33,666,705)		1,215,072,337
VII.기말의 현금및현금성자산		66,554,904,400		69,391,883,139

[별도기준]

재 무 상 태 표  
제 27 기말 2025년 12월 31일 현재  
제 26 기말 2024년 12월 31일 현재

덕산하이메탈 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기	
자산				
유동자산		81,962,003,999		95,601,658,424
현금및현금성자산	39,934,520,241		37,551,874,978	
매출채권	16,872,871,241		11,917,733,723	
기타유동수취채권	2,102,765,859		1,966,242,264	
기타유동자산	1,773,773,508		69,214,348	
기타유동금융자산	-		27,000,000,000	
재고자산	21,278,073,150		17,096,593,111	
비유동자산		183,491,392,205		302,943,385,073
당기손익-공정가치측정금융자산	19,708,855,236		38,648,390,818	
기타비유동수취채권	8,907,819,258		9,050,471,353	
종속기업 및 관계기업투자주식	118,090,434,411		220,100,209,511	
유형자산	33,013,813,497		32,988,580,498	
사용권자산	273,819,988		792,126,348	
무형자산	1,434,357,941		1,363,606,545	
이연법인세자산	2,062,291,874		-	
자산총계		265,453,396,204		398,545,043,497
부채				
유동부채		149,692,622,371		51,148,612,287
매입채무	665,144,080		401,877,102	
단기차입금	137,200,000,000		43,000,000,000	
기타유동금융부채	9,084,695,878		5,462,046,023	
기타유동부채	1,630,888,494		557,002,048	
당기법인세부채	1,111,893,919		1,719,594,543	
당기손익-공정가치측정금융부채	-		8,092,571	
비유동부채		2,106,316,510		107,829,746,527
장기차입금	-		101,200,000,000	
순확정급여부채	1,122,453,304		998,188,770	
기타비유동금융부채	158,738,787		1,241,562,222	
기타비유동부채	825,124,419		693,833,049	
이연법인세부채	-		3,696,162,486	
부채총계		151,798,938,881		158,978,358,814
자본				
자본금	9,087,400,400		9,087,400,400	

주식발행초과금	90,201,314,524		90,201,314,524	
기타자본항목	(55,238,614,379)		(55,238,614,379)	
이익잉여금	69,604,356,778		195,516,584,138	
자본총계		113,654,457,323		239,566,684,683
부채와 자본총계		265,453,396,204		398,545,043,497

포괄손익계산서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

덕산하이메탈 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 매출액	126,318,034,393	98,206,749,988
II. 매출원가	93,983,722,347	71,196,335,322
III. 매출총이익	32,334,312,046	27,010,414,666
IV. 판매비와관리비	16,771,275,265	7,493,893,057
V. 영업이익	15,563,036,781	19,516,521,609
VI. 영업외손익	(145,108,299,718)	18,890,627,142
기타수익	1,183,366,914	2,859,250,202
기타비용	123,333,236,387	2,150,059,374
금융수익	2,283,521,739	27,268,161,629
금융비용	25,241,951,984	9,086,725,315
VII. 법인세비용차감전순이익	(129,545,262,937)	38,407,148,751
VIII. 법인세비용	(3,374,372,320)	8,433,122,486
IX. 당기순손익	(126,170,890,617)	29,974,026,265
XI. 기타포괄손익	258,663,257	(931,256,148)
XII. 총포괄손익	(125,912,227,360)	29,042,770,117
XIII. 주당이익		
1. 기본주당손익	(2,777)	660
2. 희석주당손익	(2,777)	660

자본변동표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

덕산하이메탈 주식회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타자본	이 익 잉여금	총 계
2024.01.01 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	166,473,814,021	210,523,914,566
당기순이익	-	-	-	29,974,026,265	29,974,026,265
기타포괄손익	-	-	-	(931,256,148)	(931,256,148)

총포괄이익	-	-	-	29,042,770,117	29,042,770,117
2024.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	195,516,584,138	239,566,684,683
2025.01.01 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	195,516,584,138	239,566,684,683
당기순손실	-	-	-	(126,170,890,617)	(126,170,890,617)
기타포괄손익	-	-	-	258,663,257	258,663,257
총포괄손실	-	-	-	(125,912,227,360)	(125,912,227,360)
2025.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	69,604,356,778	113,654,457,323

현금흐름표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

덕산하이메탈 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,585,491,098		14,386,562,599
1. 영업으로부터 창출된 현금	12,906,375,839		23,405,235,186	
2. 이자의 수취	1,837,297,192		2,362,745,692	
3. 이자의 지급	(6,093,442,966)		(5,960,554,332)	
4. 법인세의 납부	(3,064,738,967)		(5,420,863,947)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		4,039,018,676		(15,930,660,460)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,389,879,240		40,389,359,353	
(1) 단기금융상품의 감소	27,000,000,000		36,000,000,000	
(2) 대여금의 감소	59,000,000		-	
(3) 보증금의 감소	120,370,000		210,000,000	
(4) 유형자산의 처분	2,336,364		289,805,960	
(5) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		3,443,488,393	
(6) 정부보조금의 수령	56,582,000		446,065,000	
(7) 파생상품의 정산	151,590,876		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,350,860,564)		(56,320,019,813)	
(1) 보증금의 지급	(33,300,000)		(180,070,000)	
(2) 대여금의 지급	(10,000,000)		-	
(3) 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(19,999,800,000)		-	
(4) 유형자산의 취득	(3,306,360,564)		(2,112,088,998)	
(5) 무형자산의 취득	(1,400,000)		(1,400,000)	
(6) 단기금융상품의 증가	-		(54,000,000,000)	
(7) 파생상품금융자산의 취득	-		(26,460,815)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,147,199,238)		8,540,755,550
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	32,000,000,000		10,000,000,000	
(1) 차입금의 증가	32,000,000,000		10,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(39,147,199,238)		(1,459,244,450)	
(1) 차입금의 상환	(39,000,000,000)		(1,330,658,280)	
(2) 리스부채의 상환	(147,199,238)		(128,586,170)	
IV. 현금및현금성자산의 증감( I + II + III)		2,477,310,536		6,996,657,689
V. 기초의 현금및현금성자산		37,551,874,978		29,735,774,825
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(94,665,273)		819,442,464
VII. 기말의 현금및현금성자산		39,934,520,241		37,551,874,978

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 배제
제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의 1이상</u> 으로 한다.	제35조 (이사의 수) ----- -----, <u>독립이사</u> ----- ----- <u>3분의 1</u> 이상으로 한다.	사외이사 명칭 변경 및 관련 법령 개정 반영
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사</u> 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조(이사의 의무) ① ----- ----- <u>회사 및 주주를 위하여</u> ----- -----. ② (신설) <u>이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</u> ③ 현행 제②항과 같음 ④ 현행 제③항과 같음 ⑤ 현행 제④항과 같음	상법 제382조의3 이사의 충실의무 등 개정 조문 내용 반영



부칙 제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제48조 제3항 제5항의 개정규정 (선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이 후 선임하는 감사부터 적용한다.	<삭제>	경과규정 정비
<부칙 제2조 신설>	부칙 제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제35조, 제41조의 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 제35조 이사 회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전 까지는 종전의 규정을 따른다.	관련 법령 개정 반영

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전병선	1973.09.18	사외이사	미해당	-	이사회
김별	1976.01.28	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
전병선	42dot 전략구매그룹장	2023년 ~ 현재	42dot 전략구매그룹장	없음
		2014년 ~ 2023년	Google 전략소싱 및 사업개발 리드	
		2007년 ~ 2014년	Apple 엔지니어링 프로그램 매니저	
		2002년 ~ 2007년	삼성 Semiconductor 영업운영 매니저	
김별	-	2017년 ~ 2022년	주식회사 동지 CEO	없음
		2014년 ~ 2017년	웰라(WELLA) 코리아	
		2001년 ~ 2005년	LG전자	
		2008년 ~ 2009년		

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

### 1. 전문성

후보자 전병선은 IT업계에서의 식견과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 향후 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공할 것임.

후보자 김별은 대표이사 및 사장 근무 경험으로 풍부한 경험 보유하고 있으며, 향후 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공할 것임.

### 2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로 부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

### 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

## 라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자 전병선은 글로벌 기술기업에서 신제품 개발, 전략적 소싱 및 공급망 관리 분야의 업무를 수행하며, 반도체 및 전자부품 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 회사의 사업 경쟁력 강화 및 중장기 성장 전략 수립에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

후보자 김별은 대표이사 근무 경험으로 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 추천함

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 12일

보고자 : 김 별 (서명 또는 날인)



# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호  
가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 12일

보고자 : 전 병 선 (서명 또는 날인)



---

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
실제 지급된 보수총액	9.04억원
최고한도액	100억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.12억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(<http://www.dshm.co.kr>, IR\_공시정보)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2026년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

- 당사가 정기주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

1. 회사명 : 덕산하이메탈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일

3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2026년 3월 12일

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),  
대리인 신분증